

12th Symposium on "Microjoining and Assembly Technology in Electornics"(論文集)

February 2-3, 2006 Yokohama

(c) Japan Welding Society

鉛フリーはんだにおける流動性の解析
Analysis of fluidity in lead-free solders.

末永将一* 轟木賢一郎* 西村哲郎* 古志益雄* 池田勝彦**

*(株)日本スペリア社, **関西大学工学部 先端マテリアル工学科

Shoichi SUENAGA, Kenichiro TODOROKI, Teturo NISIMURA, Masuo KOSHI and Masahiko IKEDA

*Nihon Superior Co., Ltd, **Kansai University, Department of Materials Science and Engineering

Abstract

In this study, fluidity of various lead-free solders was investigated by wetting balance test and "icicle" observation of the wetting balance test. Wet speed of the SCN solder was fast and length of its "icicle" was shorter than those of other lead-free solders. Therefore, fluidity of the SCN is better than other lead-free solders, at least the solders used in this test.

Key words; fluidity, lead-free-solders, icicle, wetting valance test

論文の購入に関するお問い合わせ先

社団法人 溶接学会

電話: 03-3253-0488 FAX: 03-3253-3059

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/proceedings.html>

<和訳>

概要

本論文では、ウェットングバランステストおよびそのテストで生じる「つらら」の観察により鉛フリーはんだの流動性について評価した。Sn-Cu-Ni 系はんだは、他の鉛フリーはんだよりも、濡れ時間は早く、「つらら」の長さは短かった。それゆえ、Sn-Cu-Ni 系はんだの流動性は、少なくともこのテストに使用した他の鉛フリーはんだよりも優れていることが確認された。